

09.10.2011 01:41

Micron und Samsung kooperieren bei Speicherwürfel

Die Entwicklung von Microns sogenanntem [Hybrid Memory Cube](#) nimmt immer konkretere Formen an und wird nun von weiteren Firmen unter anderem mit anderen Unternehmen haben Micron und Samsung das [Hybrid Memory Cube Consortium](#) (HMCC) gegründet, das zunächst eine Spezifikation für verschiedene Einsatzgebiete erarbeiten soll.

Ziel ist es, mit dem HMC die in vielen Anwendungsfällen als Flaschenhals wirkenden Datenübertragungsraten des Arbeitsspeichers massiv zu erhöhen, was der einzige Vorteil, den ein HMC gegenüber traditionellen DRAM-Modulen bieten kann. Durch die kurzen Signalleitungen ist die Leistungsaufnahme niedriger.

Bildstrecke „Micron „Hybrid Memory Cube DRAM““



Möglich wird dies, da ein HMC aus mehreren, übereinander gestapelten DRAM-Dies besteht, die mit TSV-Verbindungen direkt auf einem Substrat. Ein „Stapel-RAM“ ist an sich nicht neu und wird zum Beispiel schon von Samsung in [speziellen RDIMMs](#) eingesetzt. Der On-Chip-Controller ist nirgends zu finden und soll für den enormen Schub in Sachen Leistung sorgen.

Der 512 MB große HMC-Prototyp, den Micron Anfang September auf dem Intel Developer Forum zeigte, erreicht eine Datenübertragungsrate von 10,66 GB/s, während ein 16 GB großes DDR3-1333-Modul im Gegensatz dazu mit 10,66 GB/s deutlich im Hintertreffen ist. Auch zur Leistungsaufnahme der platzsparenden Informationen. Bezogen auf die Übertragungsrate gibt Micron für den HMC 62,23 Milliwatt pro GB/s an, während das oben beschriebene Speichermodul 100 Milliwatt pro GB/s benötigt.

Derzeit gehören dem Konsortium neben Micron und Samsung auch noch Altera, Open Silicon und Xilinx an, es steht jedoch weiteren Firmen der Unternehmensanwendungen soll es 2013 geben. Im Endkundenbereich rechnet Micron mit ersten Produkten ab 2015 oder 2016.

Google-Anzeige

Download Computer Games www.vGameNetwork.com
Free Full-Version Games Get Free Unlimited Full-Version Games

At

Empfehlen

Twittern

32 Kommentare

Mehr zum Thema



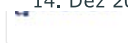
eMCP-Chips für die Einstieg- und Mittelklasse
Schnelle Smartphone-Speicherlösungen von Samsung

Sa 14:35 19 Kommentare

Effizientere Speichermodule

Micron arbeitet mit JEDEC an neuem Stacking-Standard

14. Dez 2011 21:02 4 Kommentare

**Der Würfel ist gefallen
IBM stellt Microns „Hybrid Memory Cube“ her**

2. Dez 2011 00:22 33 Kommentare

**News
Micron bereitet neue 64-GB-Byte-Speichermodule vor**

7. Nov 2011 10:21 16 Kommentare

**News
Erstes LPDDR3-DRAM der 30-nm-Klasse von Samsung**

30. Sep 2011 13:27 12 Kommentare



Themenseiten:

[Micron](#)[RAM](#)[Samsung](#)**Speicher im Preisvergleich****TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB
PC3-10667U CL9-9-9-24**

DDR3-1333

Ab € 24,-

**G.Skill DIMM Kit 8GB PC3-
10667U CL9-9-9-24**

DDR3-1333

Ab € 31,-

Google-Anzeigen

Portland's Best Teriyaki www.aieagrill.com

Teriyaki, BBQ and Noodle Plates Bowls, Sandwiches and Catering

Ask a Samsung Technician Samsung.JustAnswer.com

A Samsung Tech Will Answer You Now! A Question is Answered Every 9 Sec.

Google Offers in Portland www.google.com/offers

The best of Portland at even better prices. Sign up today!